

DLAP-211-Orin Series

超紧凑、无风扇、边缘AI平台，适用于多种AI应用

功能

- 内置 NVIDIA® Jetson Orin NX / Nano™ 模块，最高可提供100 TOPS 运算能力
- 支持 NVIDIA Super Mode，可将 AI TOPS 提升至 1.7 倍，内存带宽提升至 1.5 倍，Gen AI 模型性能提升至 2 倍
- 体积小巧，尺寸仅为148mm x 120mm x 52mm，采用无风扇设计
- 工作温度范围从-20°C到70°C • 多功能I/O端口，可选配FM板扩展
- 适用于智慧城市、零售、制造等各类AI应用
- 开发套件（不含底盘SKU）可购买



订购信息

PN	型号名称	NVIDIA 模块	NVIDIA 模块存储器	NVMe	扩展智能裁剪
93-45103-0420	DLAP-211-Orin NX 16GB	奥林 NX	16GB	128GB	N/A
93-45103-0320	DLAP-211-Orin NX 8GB	奥林 NX	8GB	128GB	N/A
93-45103-1310	DLAP-211-Orin Nano 8GB	奥林纳米	8GB	128GB	N/A
93-45103-1210	DLAP-211-Orin Nano 4GB	奥林纳米	4GB	128GB	N/A
93-45103-1C10	DLAP-211-Orin Nano 8GB Super	奥林纳米	8GB	128GB	N/A
93-45103-1B10	DLAP-211-Orin Nano 4GB Super	奥林纳米	4GB	128GB	N/A
93-45103-4220	DLAP-211-Orin NXS 16GB	奥林 NX	16GB	128GB	是
93-45103-4410	DLAP-211-Orin NXS 8GB	奥林 NX	8GB	128GB	是
93-45103-5210	DLAP-211-Orin NanoS 8GB	奥林纳米	8GB	128GB	是

* 操作系统安装在 NVMe 128GB上。如果需要更换 NVMe 容量，请咨询服务窗口

装箱单

PN	描述	量	笔记
93-45103-XXXX	DLAP-211	1	N/A
31-62157-1010-A0	84W, 适配器, 12V/7A, 直流插孔 Ø2.5	1	适用于Orin NX16GB 和 Orin Nano Super
31-62156-1010-A0	60W, 适配器, 12V/5A, 直流插孔 Ø2.5	1	Orin Nano, Orin NX 8GB
33-01200-0050	M2.5螺钉, P型头, L5	3	N/A
34-34334-0000-A0	VESA支架	1	N/A
33-04302-0050	M4螺钉, I型头, L5.0	4	N/A
33-04603-0080	M4 螺钉, HW头, L8.0	4	N/A
47-90004-0010	技术服务卡	1	N/A
50-40375-9000	CN和TW RoHS声明的模板A	1	N/A

可选配件

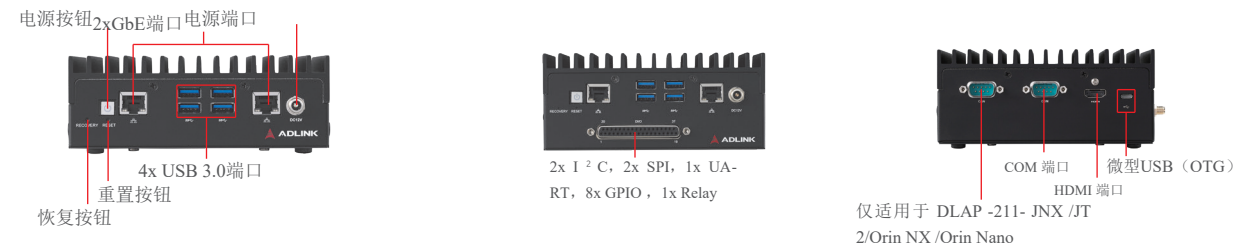
PN	描述	笔记
91-49074-000E	Wi-Fi 套件, M2-R8852BE, 带 mPCIe转换器	N/A
91-95301-0010	DIN RAIL, DLAP -211 系列 DIN RAIL套件	N/A
95-36400-4E10	M2ASDED4EDE-128GT0-N	NVMe
95-36400-5E10	ASDED4EDE-256GT0-N	NVMe
95-36400-6E10	ASDED4EDE-512GT0-N	NVMe
95-34400-7400	ASDSM4SHE-1TBT0	SATA

规格

模型	Orin NX 8GB	Orin NX 16GB	Orin Nano 4GB	Orin Nano 4GB 极好的	Orin Nano 8GB	Orin Nano 8GB 极好的
AI 性能	70 顶部	100 顶部	20 TOPS	34 TOPS	40 TOPS	67 TOPS
体系						
GPU	1024核 NVIDIA 安培GPU， 配备 32 张量核心		512核 NVIDIA 安培架构GPU， 配备16 个张量核心		1024核 NVIDIA 安培架构GPU， 配备32个张量核心	
中央处理器	6核Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3	8核Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3	6核Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位CPU 1.5MB L2 + 4MB L3			
RAM	8G	16G	4G		8 G	
存储	NVMe 128GB					
操作系统	Linux® Ubuntu					
前端 I/O 接口						
按钮	1x电源，1x复位，1x恢复					
高密度多芯片互连	1x 可锁定					
统一的S波段	4x USB 3.0 Type-A					
以太网	2x 10/100/1000Mbps 以太网					
仅适用于 S 型号	2x I2-C, 2x SPI, 1个UART接口、8个 GPIO 接口、1个继电器接口， 均通过1个37针D型连接器实现					
回退 I/O 接口						
统一的S波段	1x USB 2.0 OTG					
串行端口	1x COM RS-232/RS-422/RS-485					
CAN总线	1x 2.0b					
扩展槽						
微型 PCIe	1 个 PCIe 迷你卡插槽					
电源						
DC输入	12V					
交流输入	60W，输出端温度 Max： 45°C	84W， 额定最高 温度： 55°C	60W， 额定最高温度： 45°C； 84W， 额定最 高温度： 55°C（奥林纳诺超级版）			
机械						
尺寸 (W x D x H)	148毫米×120毫米×52毫米（DLAP -211-Orin NX /Orin Nano） 148毫米×120毫米×64毫米（DLAP -211-Orin NXS /Orin NanoS）					
权重	毛重1.7kg/净重1.01kg（DLAP -211-Orin NX /Orin Nano） 毛重1.85kg/净重1.16kg（DLAP -211-Orin NXS /Orin NanoS）					
正在上传	VESA， DIN导轨（可选）					
SMA天线连接器	4					
环境的						
工作温度	-20°C至70°C， 0.6m/s气流， 10W -20°C至60°C， 0.6m/s气流， 15W -20°C至50°C， 0.6m/s气流， 25W 在 MAXN 环境下， 温度范围为-20°C至40°C， 气流速度为0.6米/秒。mPCIe接口部件需采用工业级零件（Tamb 标准规定最高温度为85°C）。					
正在运行 湿度	约95% @40°C（不凝结， 可选无风扇溶液） 不使用适配器					
储存温度	-40°C至85°C					
振动	运行5Grms， 5-500Hz， 3轴带M.2 SSD					
震惊	运行100G， 半正弦11ms持续时间， 带SD， M.2 SSD					
ESD	接触电压±4kV， 空气电压±8kV					
规律性	CE与面心立方B类，（EN61000-6-4/-6-2）， CE- LVD 与UL由CB认证， FCCID					
F/W支持						
WDT	已支持 WDT					

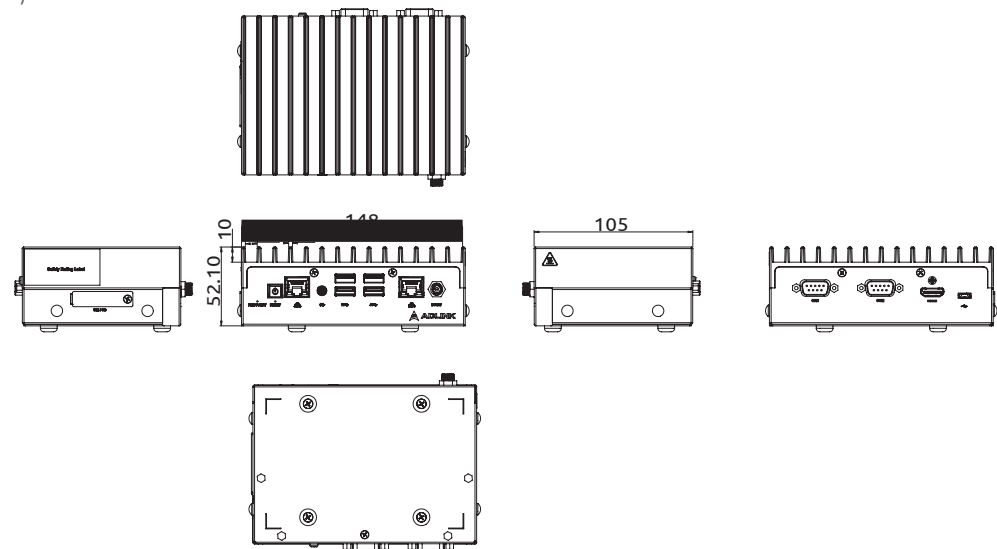
输入/输出视图

仅 OFin NXS / OFin NanoS



产品尺寸和插图

DLAP-211-Orin NX/Nano



DLAP-211-Orin NXS/NanoS

